

# 2022年度 第2四半期 決算説明資料

2022.10.20

## 将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2022	FY2022	QoQ		FY2021	YoY	
	2Q	1Q	差額	(%)	2Q	差額	(%)
売上高	79,532	59,749	19,783	33.1%	67,791	11,741	17.3%
売上総利益	52,055	38,135	13,920	36.5%	40,415	11,639	28.8%
GP率	65.5%	63.8%	1.7p	-	59.6%	5.9p	-
販売管理費	18,776	16,542	2,234	13.5%	15,902	2,874	18.1%
営業利益	33,278	21,592	11,686	54.1%	24,513	8,765	35.8%
経常利益	34,819	22,763	12,057	53.0%	25,144	9,675	38.5%
経常利益率	43.8%	38.1%	5.7p	-	37.1%	6.7p	-
税前利益	34,798	22,737	12,060	53.0%	25,119	9,679	38.5%
純利益	24,633	16,039	8,594	53.6%	18,010	6,623	36.8%

売上高： QoQ 検収タイミングによる変動 YoY 高水準の出荷・検収による増加  
 GP率： 為替の影響や改善活動の継続などで収益性上昇  
 販売管理費： 人件費および研究開発費を中心に高水準で推移

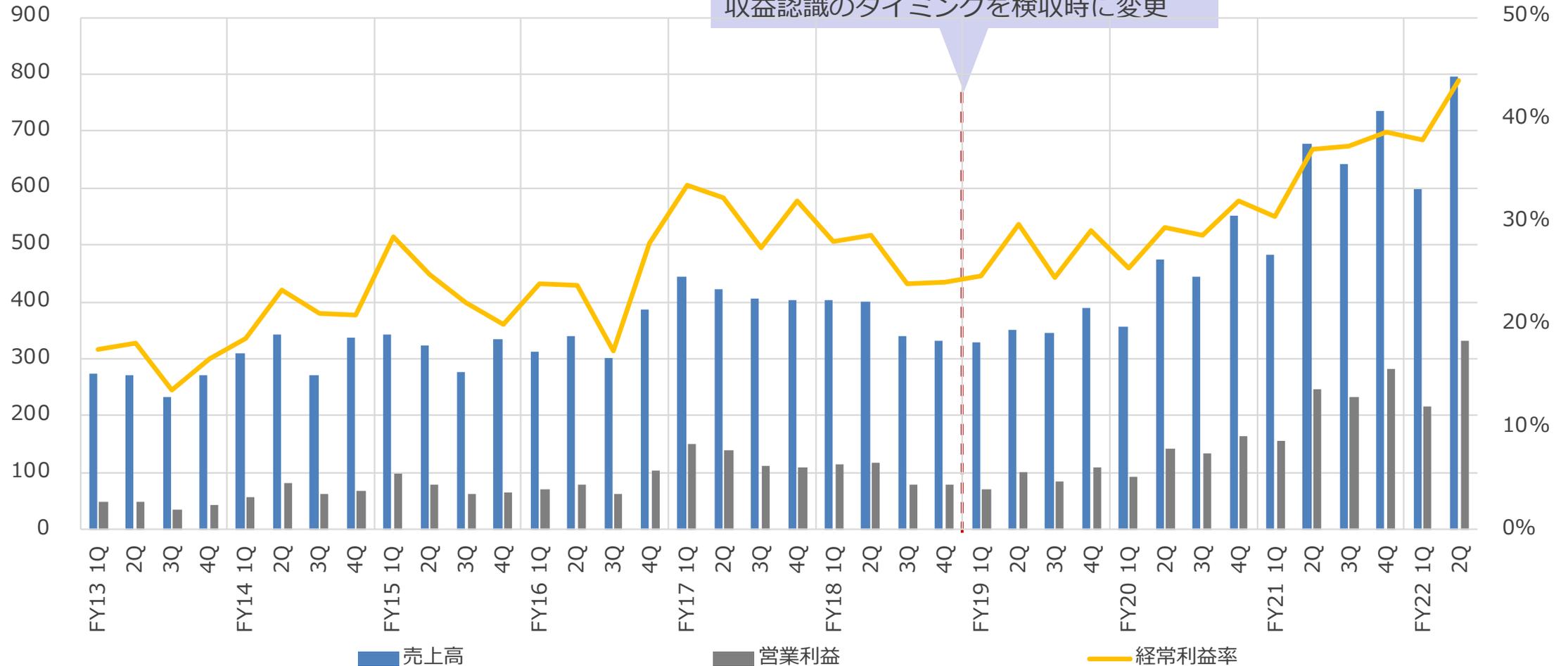
(単位：百万円)	FY2022	FY2021	YoY	
	1H	1H	差額	(%)
売上高	139,281	116,082	23,200	20.0%
売上総利益	90,190	69,843	20,347	29.1%
GP率	64.8%	60.2%	4.6p	-
販売管理費	35,319	29,885	5,434	18.2%
営業利益	54,870	39,958	14,913	37.3%
経常利益	57,582	39,895	17,687	44.3%
経常利益率	41.3%	34.4%	6.9p	-
税 前 利 益	57,536	39,835	17,701	44.4%
純 利 益	40,673	28,592	12,081	42.3%

売上高： YoY 高水準の製品出荷と検収の進捗により大幅増

GP率： YoY 為替影響や改善活動などにより上昇

販売管理費： YoY 主に人件費および研究開発費が増加

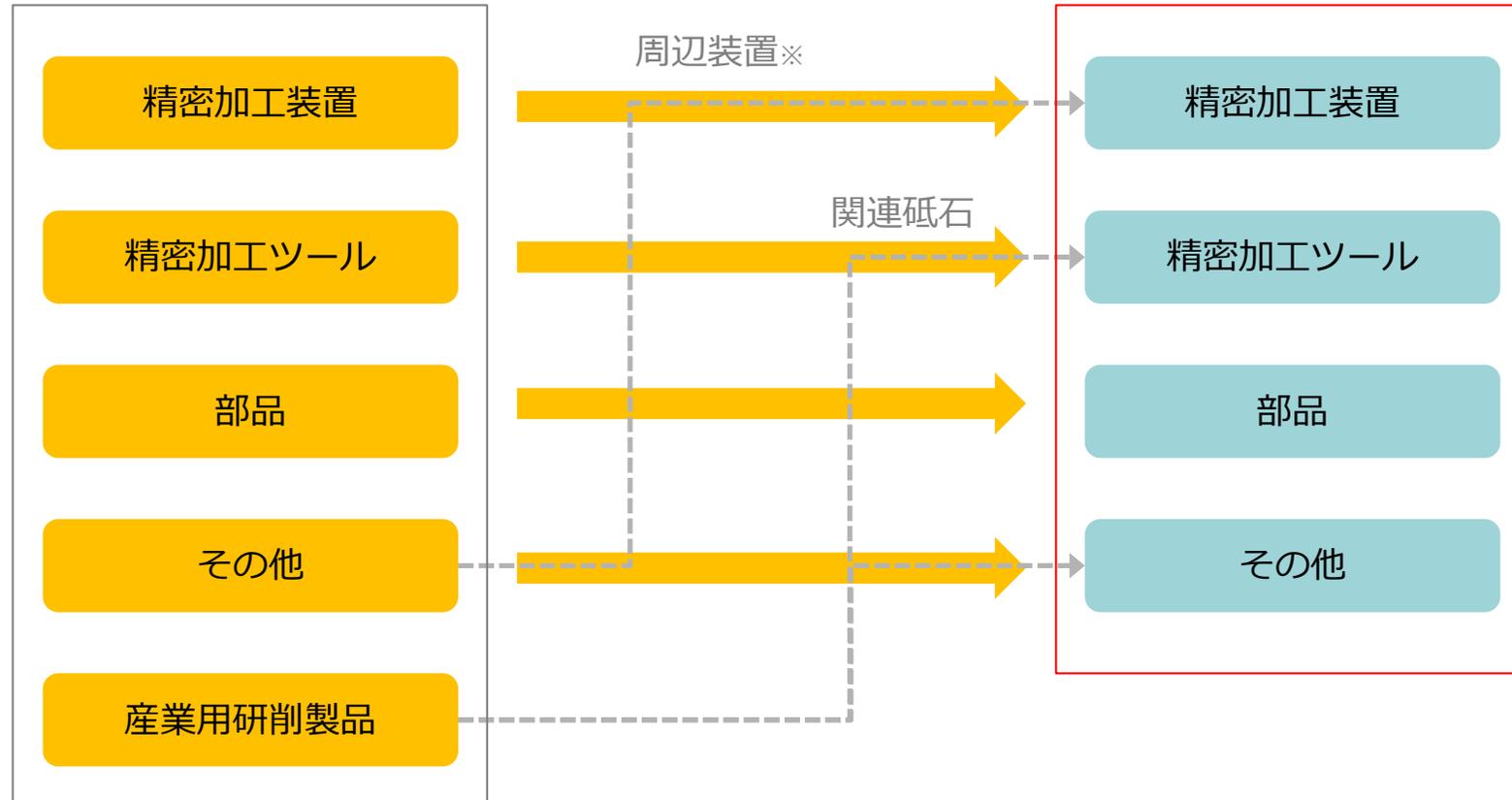
(単位：億円)



各利益において最高益となり、営業利益率は初めて40%台を記録  
 (FY22\_2Q 営業利益率41.8% 経常利益率43.8% 純利益率31.0%)

従来分類 (FY21まで)

新分類 (FY22以降)

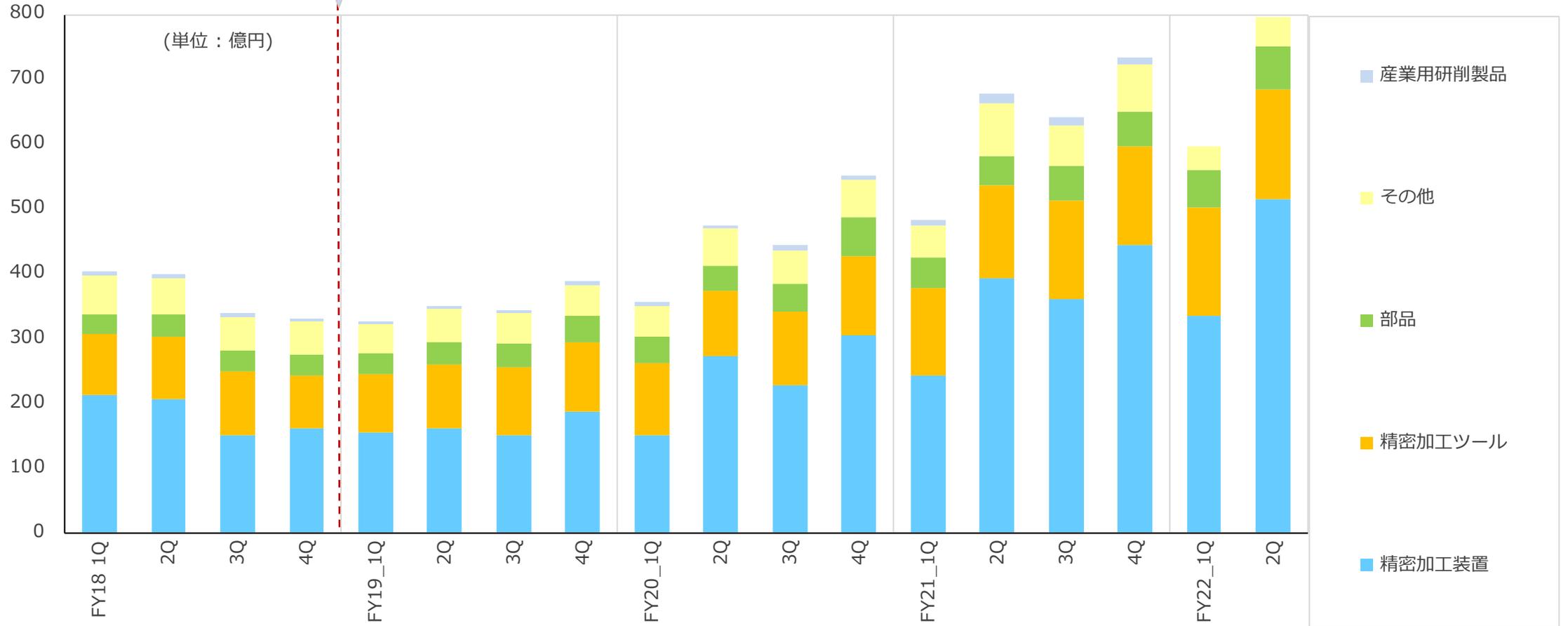


※ウェーハマウンタ、純水リサイクル装置など

「その他」および「産業用研削製品」について分類を変更

# 製品群別売上高 四半期推移

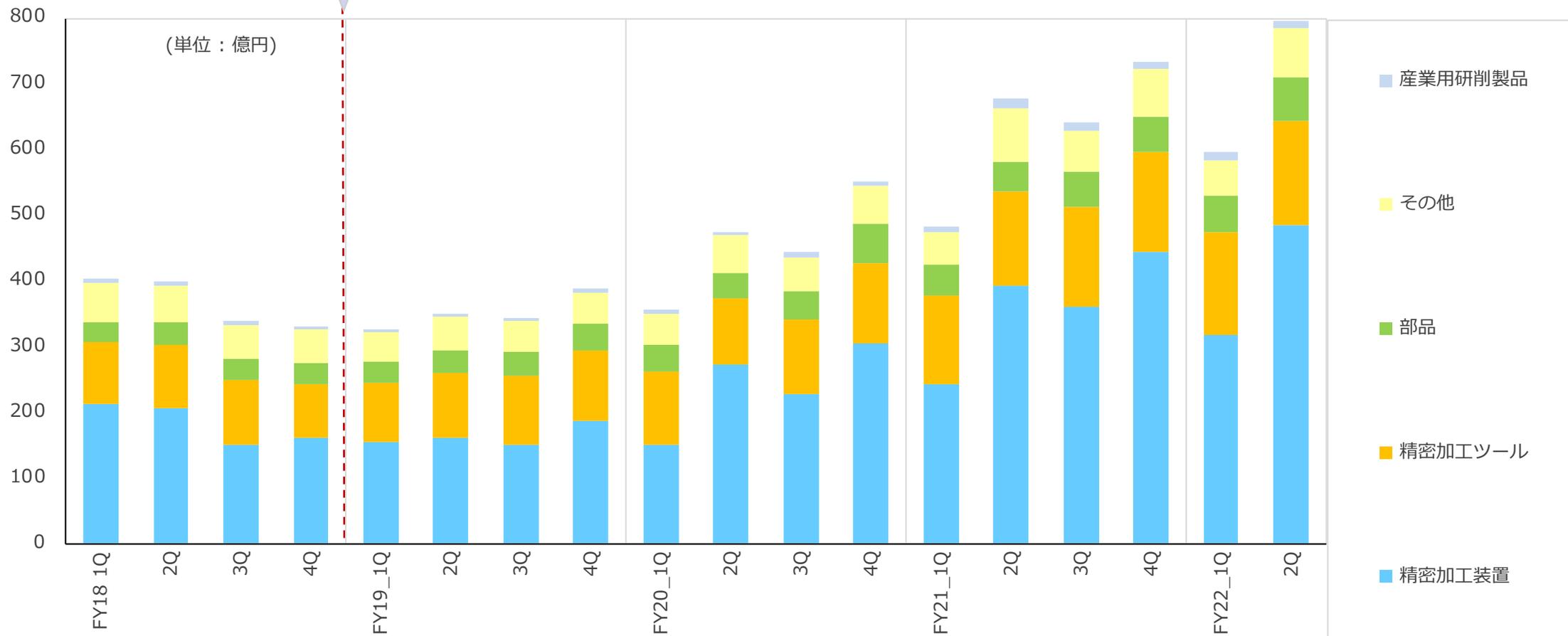
会計方針の変更



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

# 【参考】製品群別売上高 四半期推移

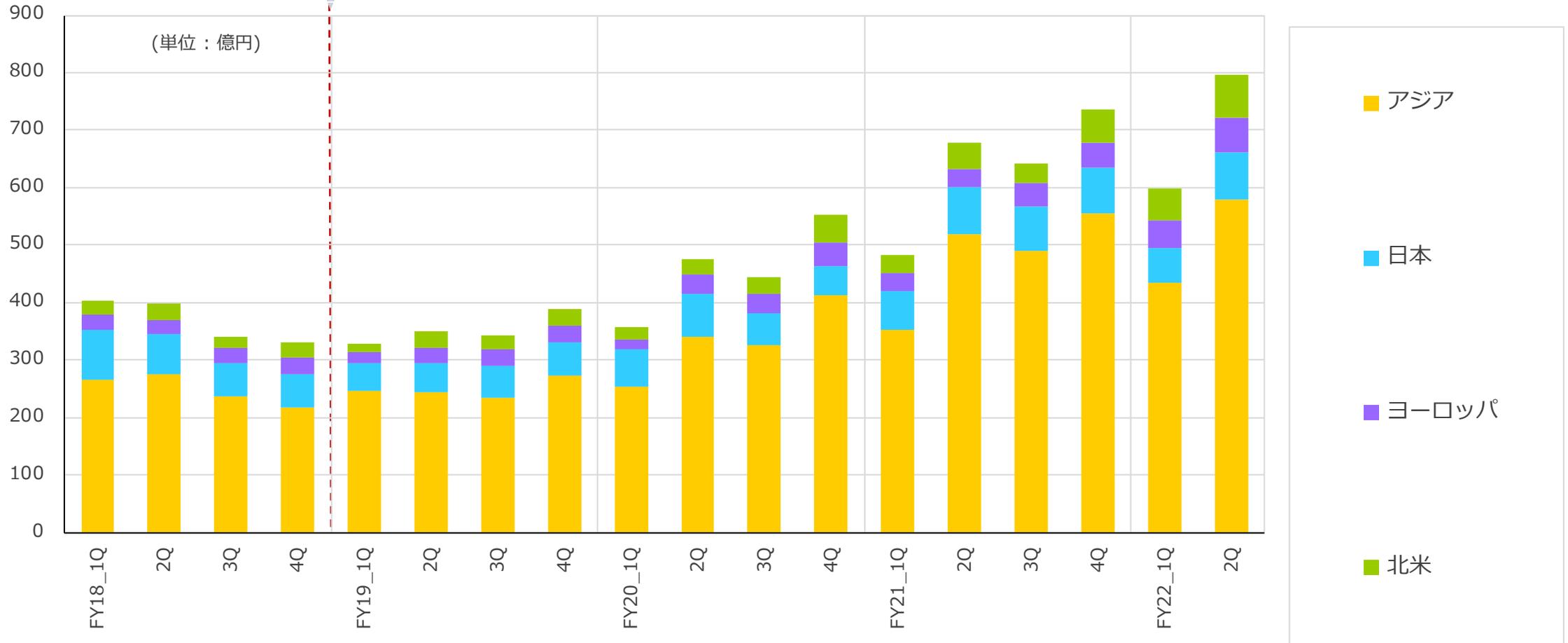
会計方針の変更



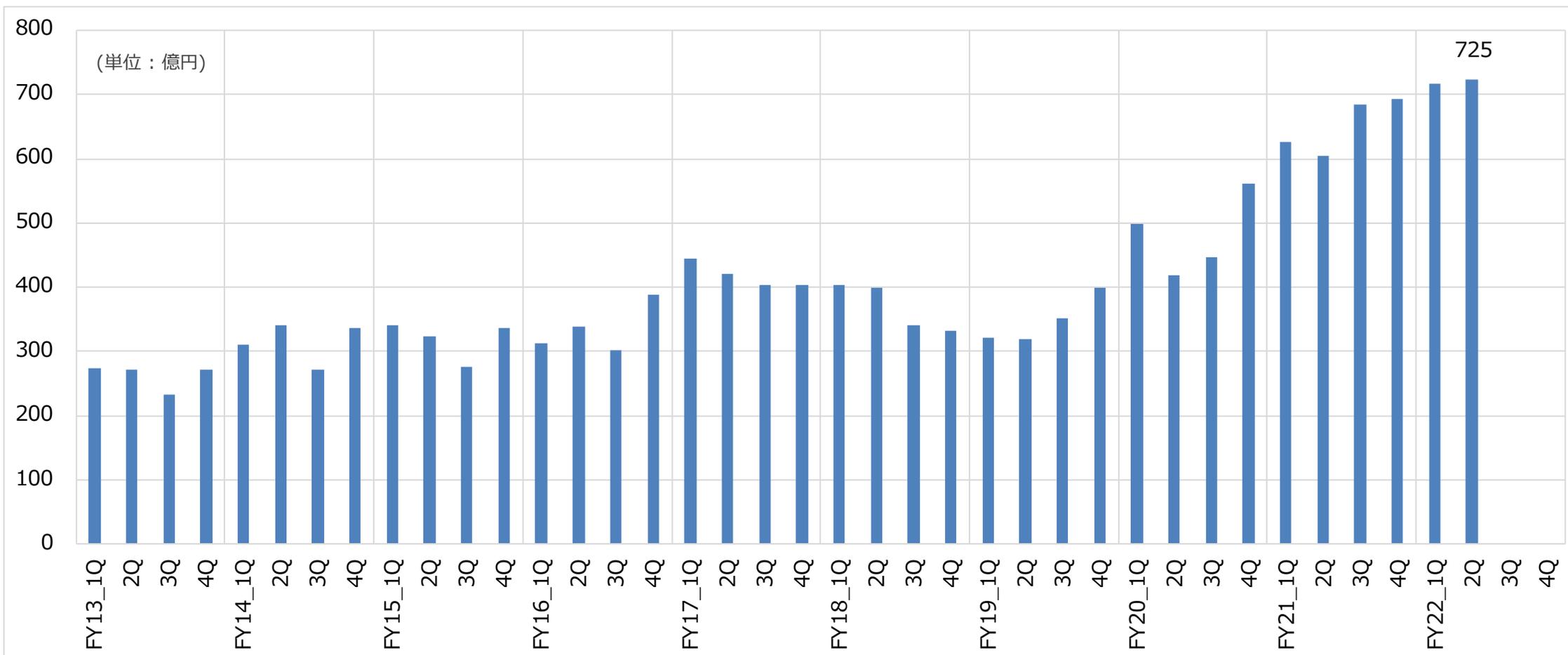
従来分類による推移

# 地域別売上高 四半期推移

会計方針の変更

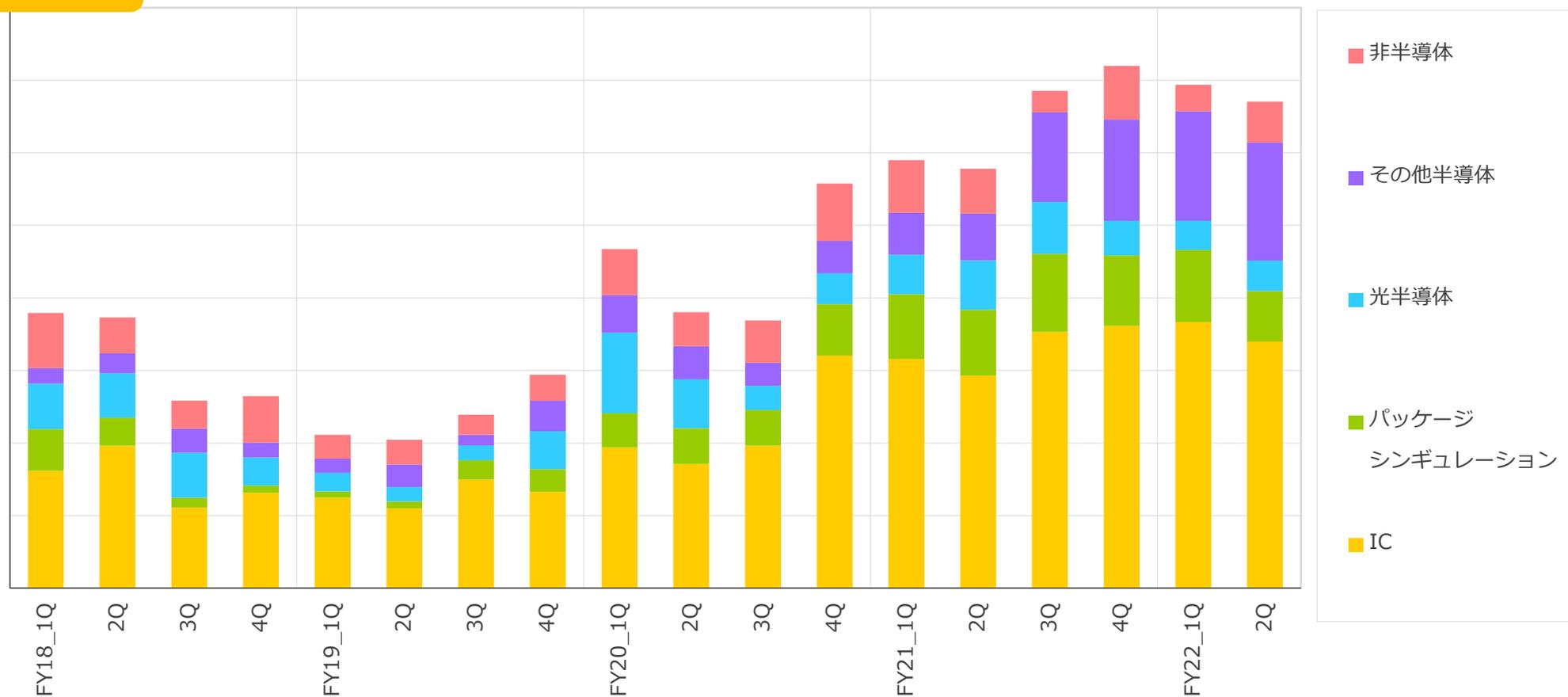


FY22\_2Q 海外売上高比率 89.5%



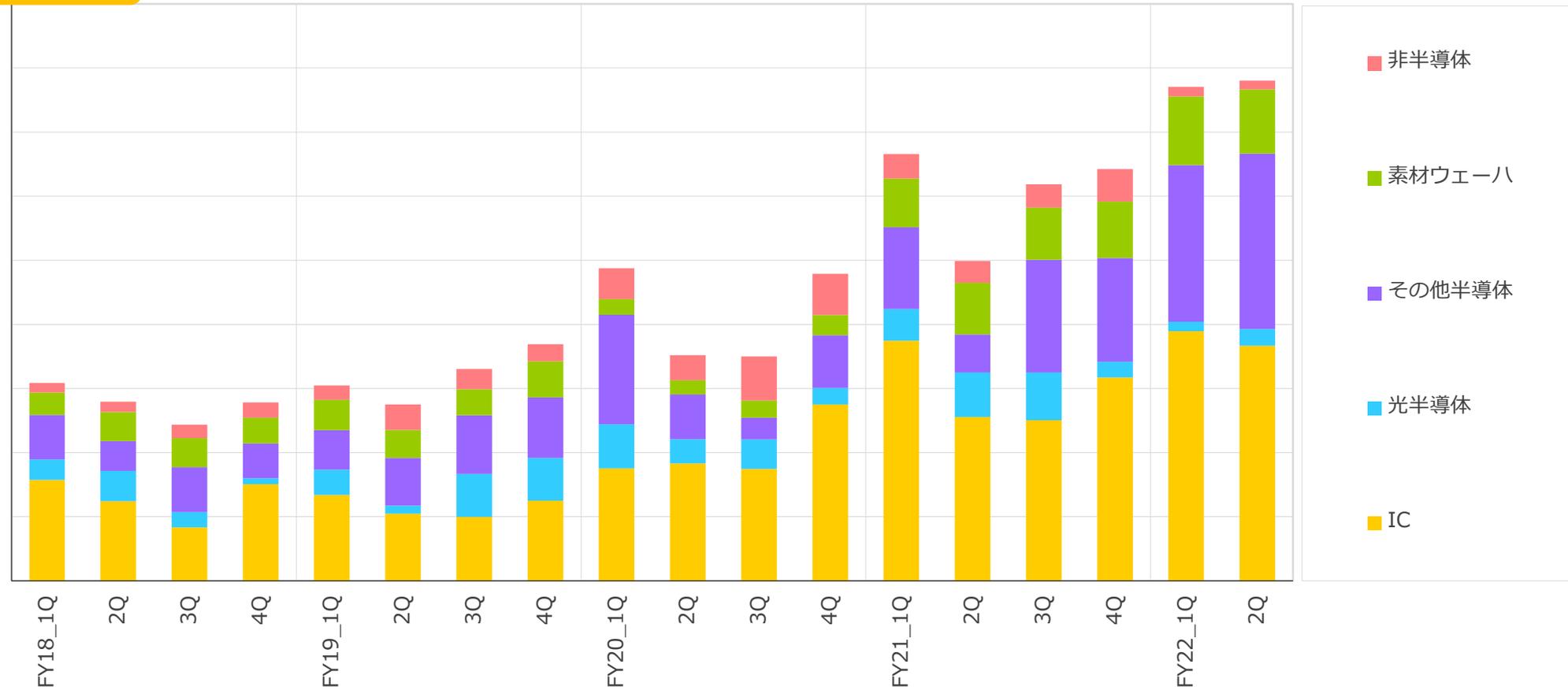
FY22\_2Q 出荷額 約725億円

## 出荷額ベース

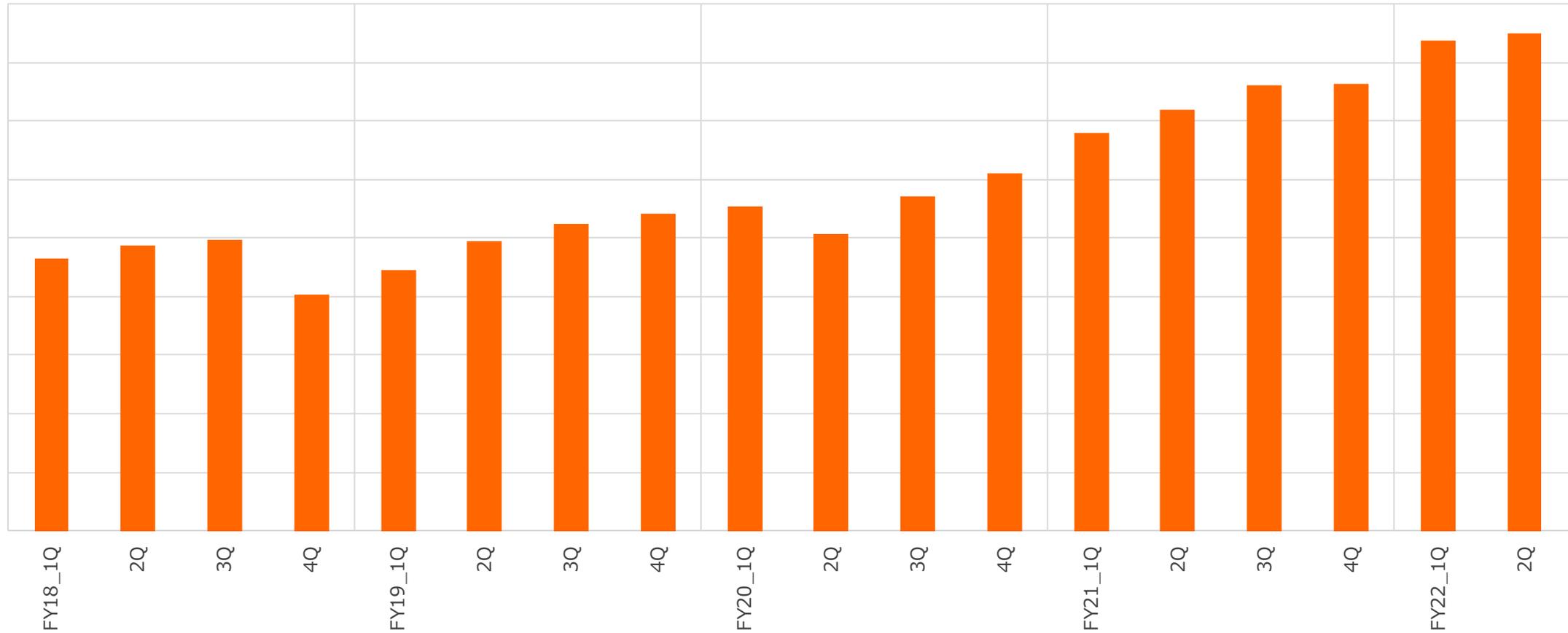


QoQ YoY OSAT向けは減少するも、パワー半導体（その他半導体）は好調維持  
 パワー半導体（その他半導体）の伸びが全体を押し上げた

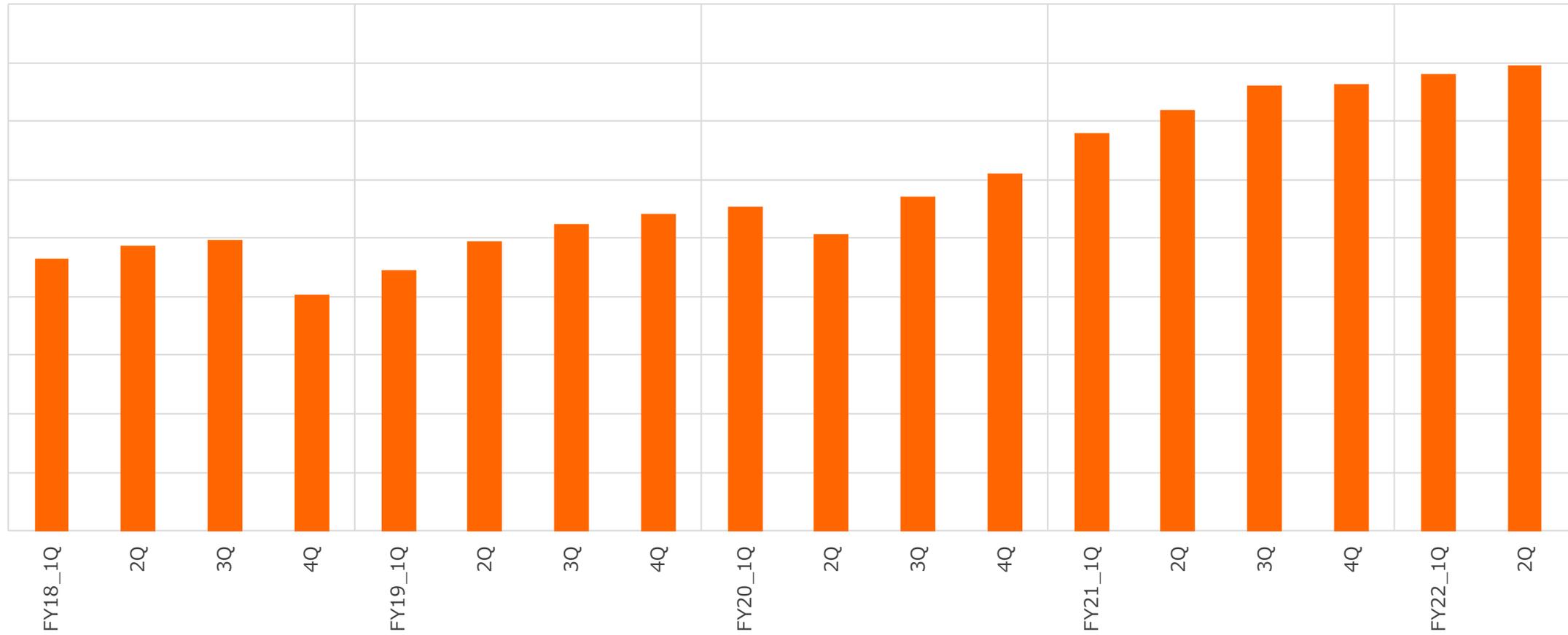
## 出荷額ベース



QoQ EVシフトなどを背景としたパワー半導体（その他半導体）向けが全体を押し上げた  
 YoY パワー半導体、素材ウェーハ向けなど幅広い用途で半導体需要が拡大



精密加工ツール（消耗品）の出荷は高水準  
※FY22\_1Qより、従来他区分だった「関連砥石」を含む



従来分類による推移

(単位：百万円)	FY2022 2Q	FY2022 1Q	差額
現金及び預金	136,405	113,382	23,023
受取手形・売掛金	41,839	40,115	1,725
たな卸資産	83,840	78,729	5,111
流動資産	267,867	235,539	32,329
有形固定資産	146,572	145,145	1,427
固定資産	160,298	158,733	1,565
総資産	428,166	394,273	33,893
流動負債	110,456	103,389	7,067
固定負債	932	913	19
負債合計	111,389	104,303	7,086
純資産	316,776	289,969	26,807
負債純資産合計	428,166	394,273	33,893
自己資本比率	73.7%	73.3%	0.4p

総資産：現預金が増加、たな卸資産は原材料を中心に増加

負債：主に未払法人税等が増加

純資産：主に利益剰余金が増加

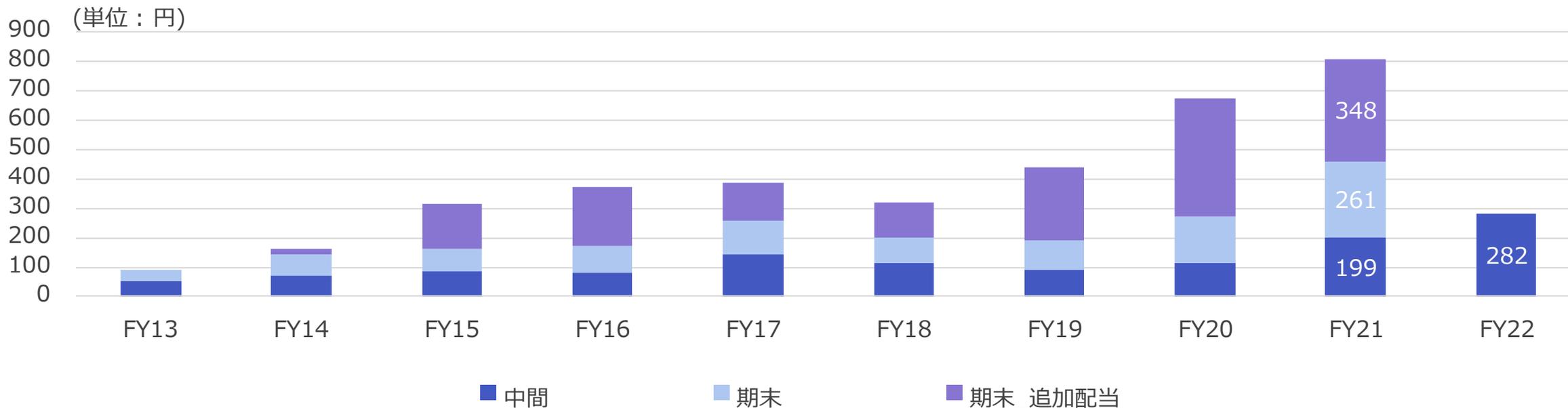
(単位: 百万円)	FY2022 1H	FY2021 1H	差額
営業キャッシュ・フロー	38,261	31,820	6,441
税前当期利益	57,536	39,835	17,701
減価償却	4,912	3,713	1,199
売上債権の増減	-524	-3,933	3,409
たな卸資産の増減	-14,191	-4,713	-9,478
仕入債務の増減	2,096	1,776	320
法人税支払い	-19,464	-12,998	-6,466
その他営業CF	7,896	8,140	-245
投資キャッシュ・フロー	-7,379	-9,671	2,292
有形固定資産の取得	-7,399	-9,615	2,216
その他投資CF	19	-55	76
フリー・キャッシュ・フロー	30,882	22,149	8,733
財務キャッシュ・フロー	-21,965	-20,026	-1,939
配当金支払い	-21,974	-20,218	-1,757
現金同等物増減	10,633	3,075	7,559
期首残高	125,771	109,809	15,962
期末残高	136,405	112,884	23,520

- 営業CF・・・約382億円 資金増加  
主に税前利益による資金増加
  - 投資CF・・・約73億円 資金減少  
主に有形固定資産の取得によるもの
  - フリー・キャッシュ・フロー  
約308億円の資金増加
  - 財務CF・・・約219億円 資金減少  
主に配当金の支払い
- 9月末の現金残高 約1,364億円

## 【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(\*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

\*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY22 中間（実績）282円 期末 未定

(単位：億円)

今回予想

	FY21 1Q	2Q	3Q	4Q	FY22 1Q	2Q	3Q
売上高	483	678	642	735	597	795	673
営業利益	154	245	233	283	216	333	249
経常利益	148	251	240	286	228	348	251
純利益	106	180	169	207	160	246	177
営業利益率	32.0%	36.2%	36.3%	38.4%	36.1%	41.8%	37.0%
経常利益率	30.5%	37.1%	37.4%	38.8%	38.1%	43.8%	37.3%
純利益率	21.9%	26.6%	26.4%	28.2%	26.8%	31.0%	26.3%
出荷額	627	604	684	694	717	725	763

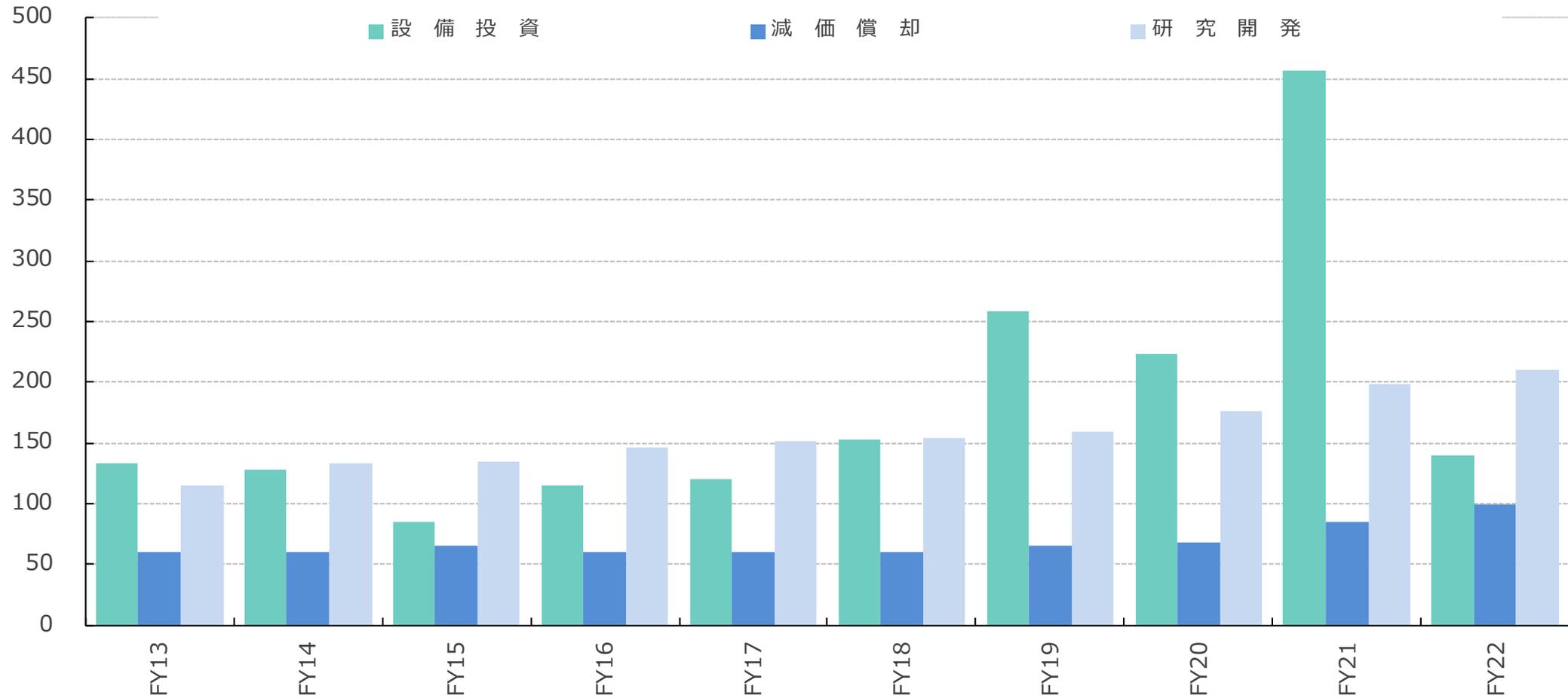
※億円未満 四捨五入

想定為替レート  
為替感応度（年換算）

US\$ : 135円      Euro : 130円  
US\$ : 約12億円      Euro : 約3千万円

出荷額ベース

製品群		見通し FY22_3Q 増減率 (QoQ)
精密加工装置	ブレードダイサ	-15%
	レーザーソー	30%
	<b>ダイサ</b>	<b>横ばい</b>
	薄化DGP	60%
	薄化以外	20%
	<b>グラインダ</b>	<b>45%</b>
<b>周辺装置</b>	<b>45%</b>	
精密加工装置		20%
精密加工ツール		-10%
その他		-25%

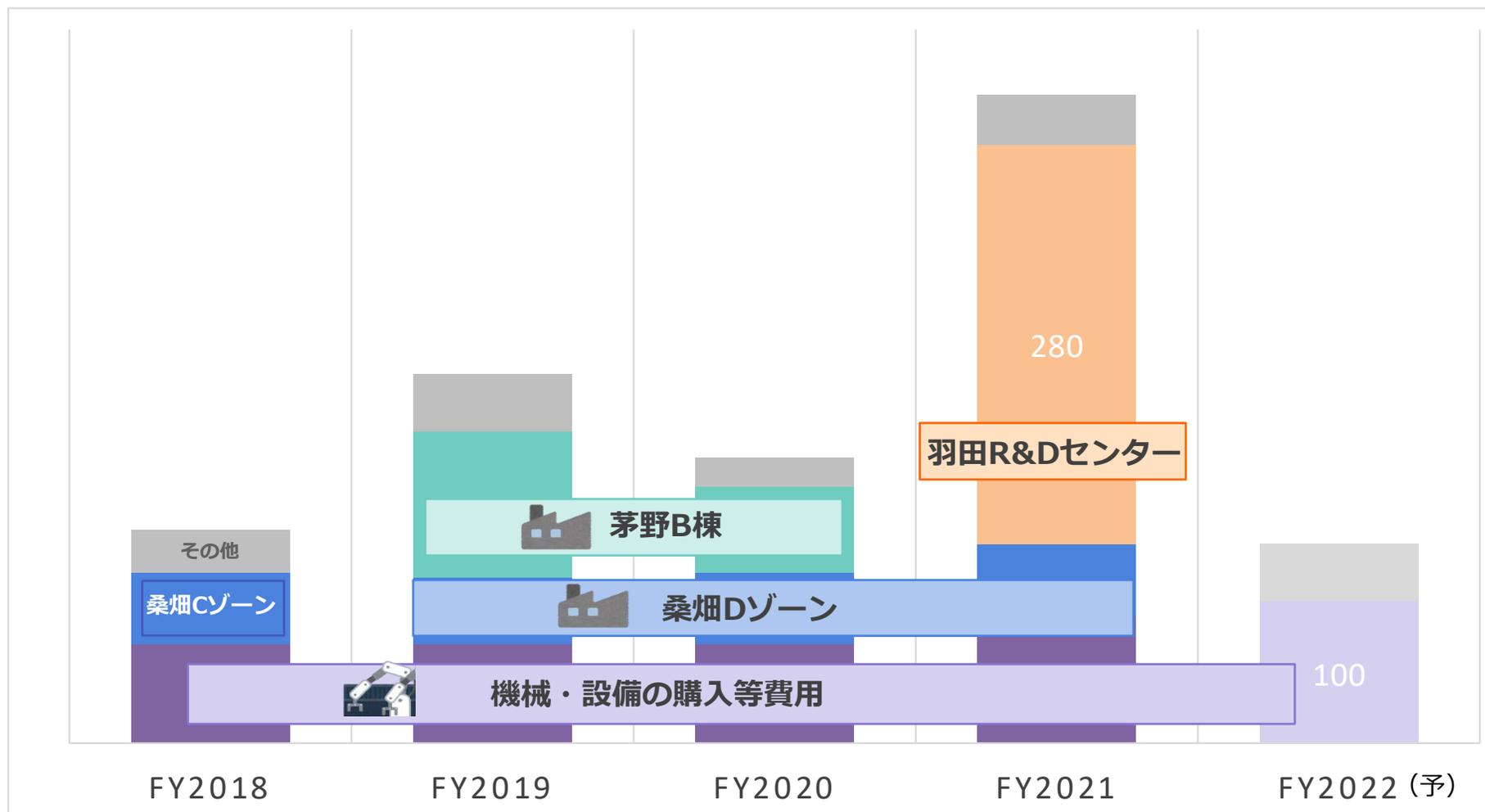


見通し

FY22見通し 設備投資：合理化投資を中心に実施  
 減価償却：前年度取得資産の償却  
 研究開発：積極的な研究開発を予定

140億円程度 (FY21実績 456億円)  
 100億円前後 (FY21実績 85億円)  
 210億円前後 (FY21実績 198億円)

単位：億円



FY22見通し

機械・設備の購入等費用  
他 オフィス拡張など

約100億円  
約40億円

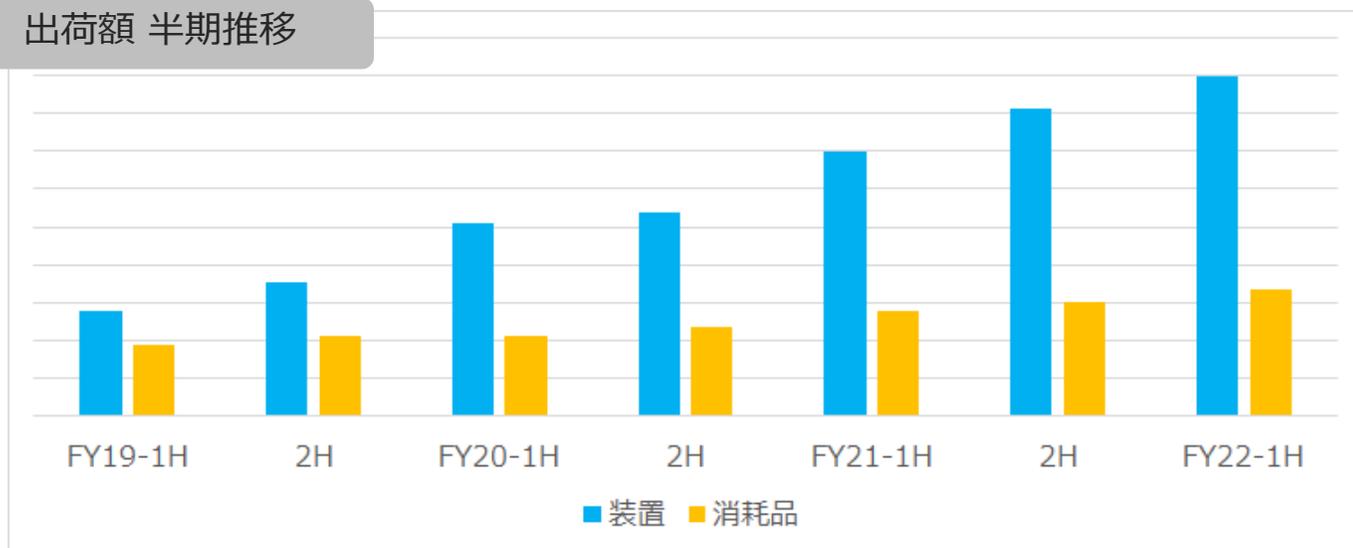
## ■ 出荷動向

上期出荷額は過去最高を記録

足元、量産用途の投資意欲は減退

一方でパワー半導体などの需要が強く出荷は高水準

出荷額 半期推移



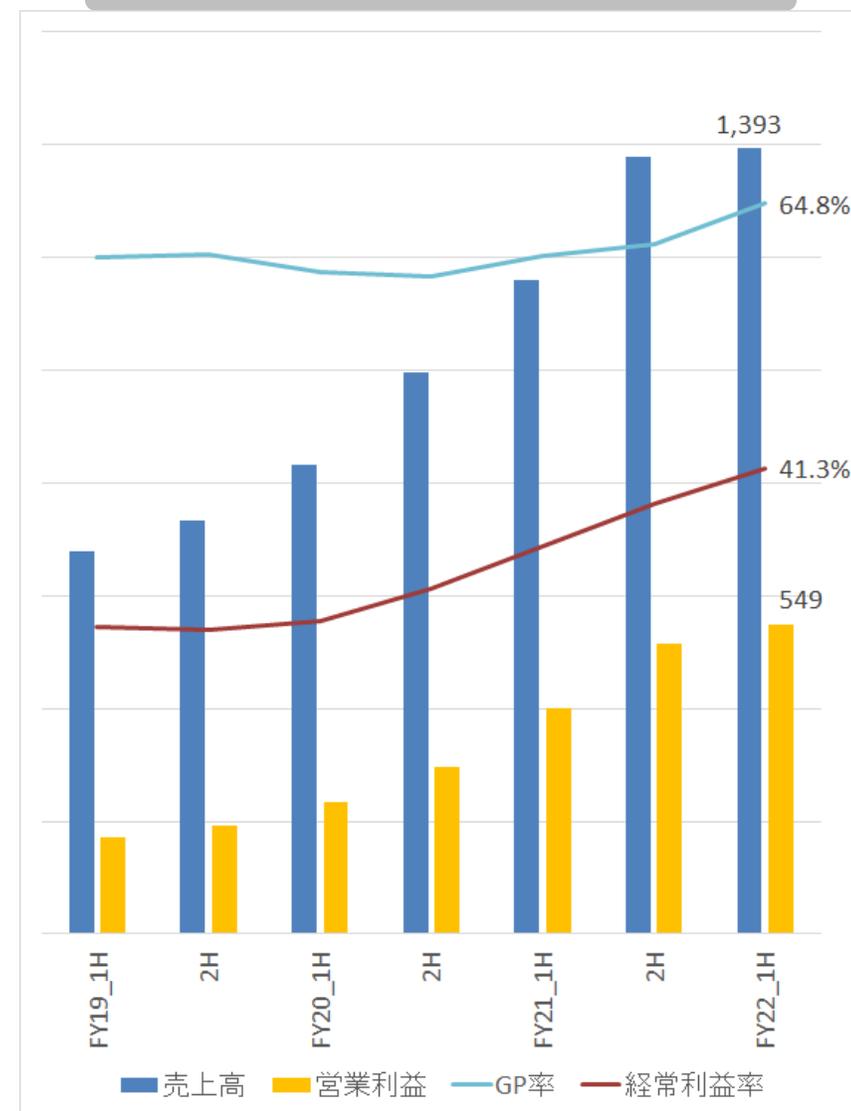
## ■ 収益性は上昇傾向、足元の為替市況は業績に追い風

PIM活動による付加価値創出と原価低減などでGP率が上昇

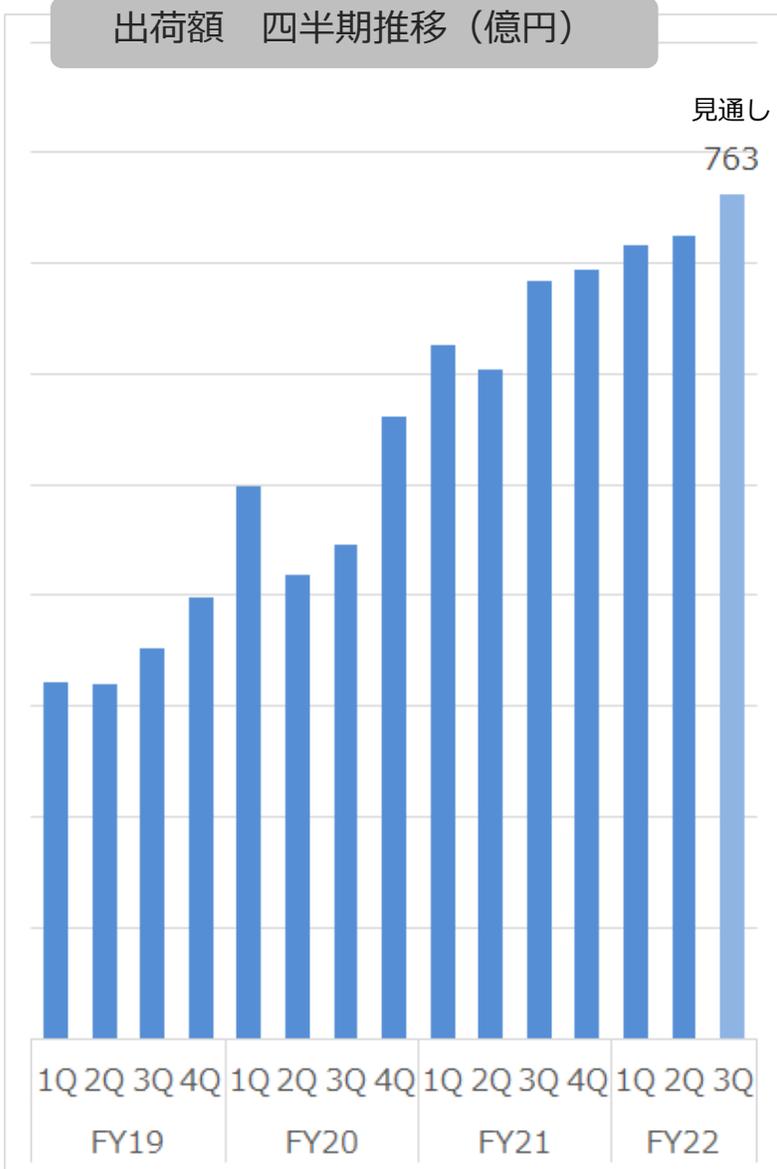
経常利益率は40%台と高水準を記録

## ■ 中間配当は業績連動により282円 (前年中間199円から大幅増配)

半期推移 (検収基準) 単位: 億円



出荷額 四半期推移 (億円)

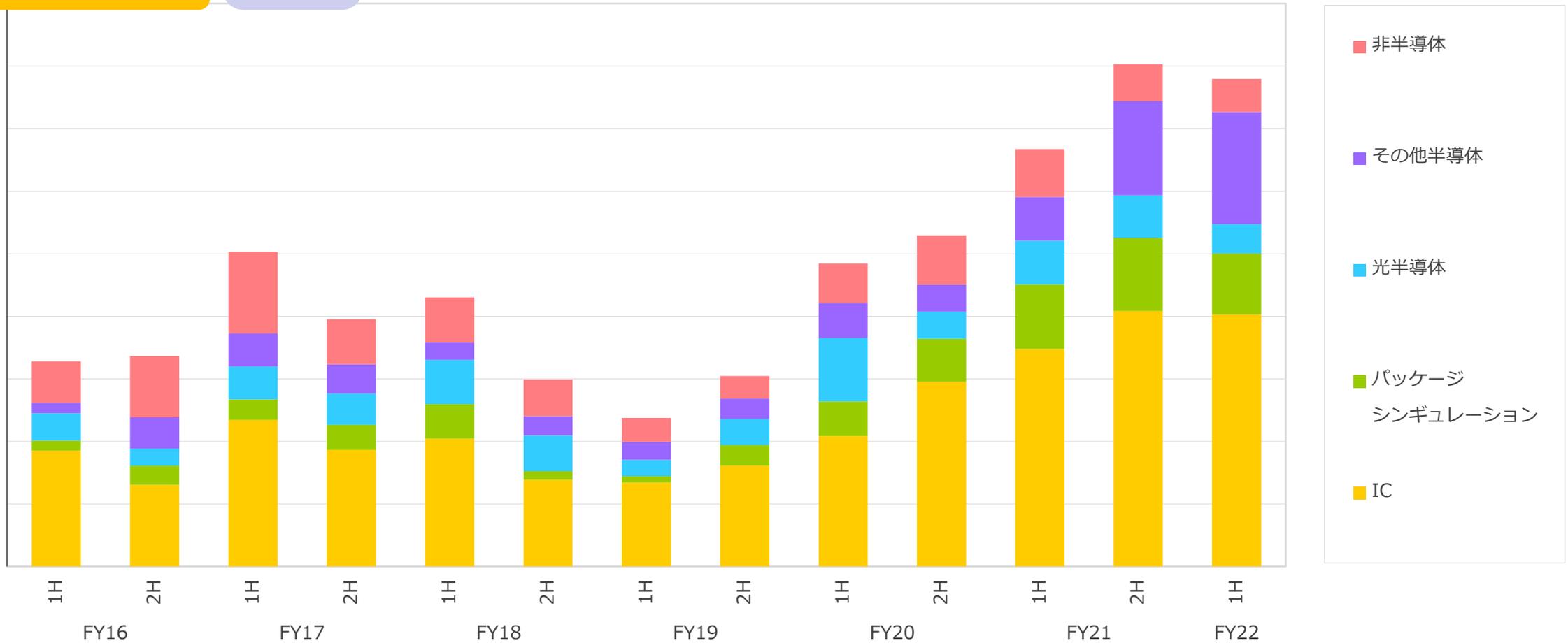


- パワー半導体などの需要を背景に、グラインダを中心に装置は高水準の出荷が継続する見込み
- 量産用途向け装置需要は、今後の消耗品出荷状況を含め注視
- 米国による半導体法案や規制など半導体サプライチェーンの動向を含めて注視
- 繁忙・閑散など環境変化を問わず「会社を強くする」取り組みを継続  
DISCO VALUES、Will会計、PIM活動を通じて組織経営と事業経営に注力
- 「高度なKKM技術」の開発テーマは増加、全力で対応中

- 【ご参考】 半期推移 グラフ集

出荷額ベース

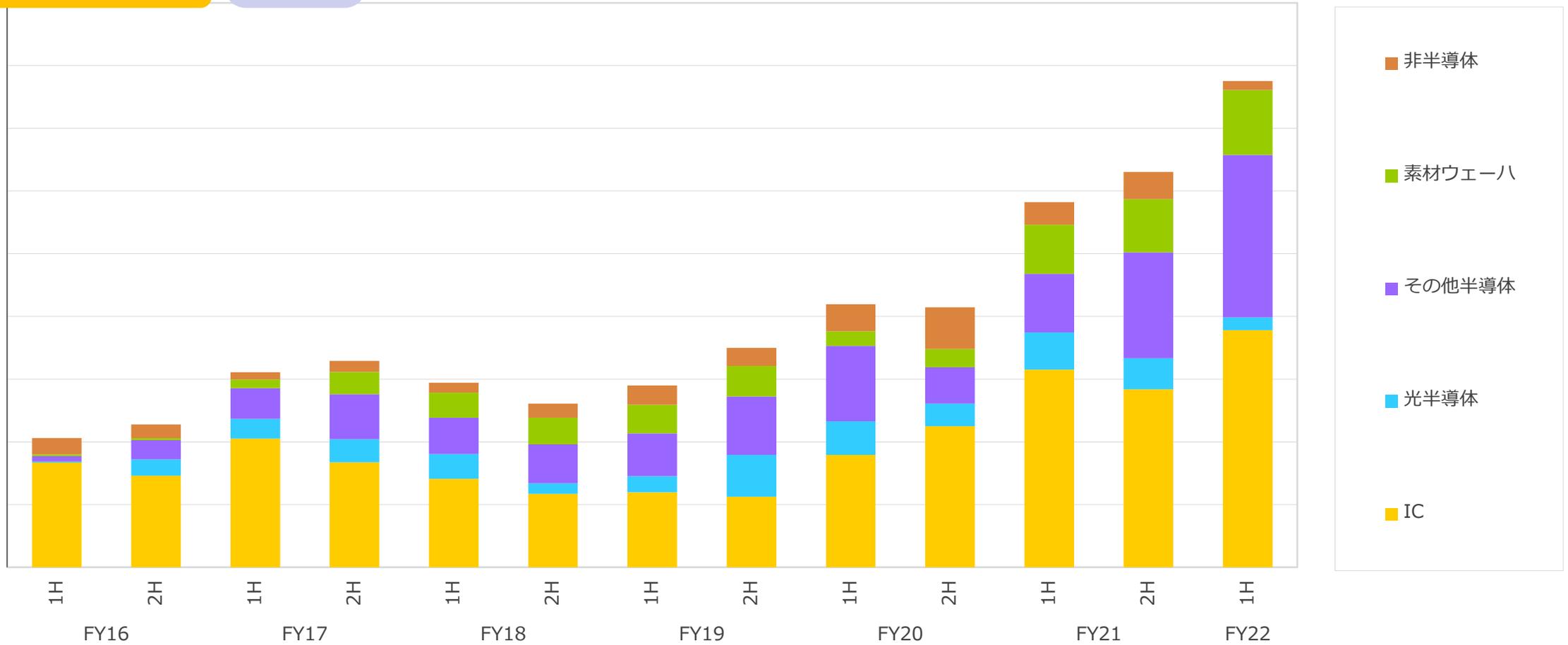
半期



# グラインダ用途別売上高

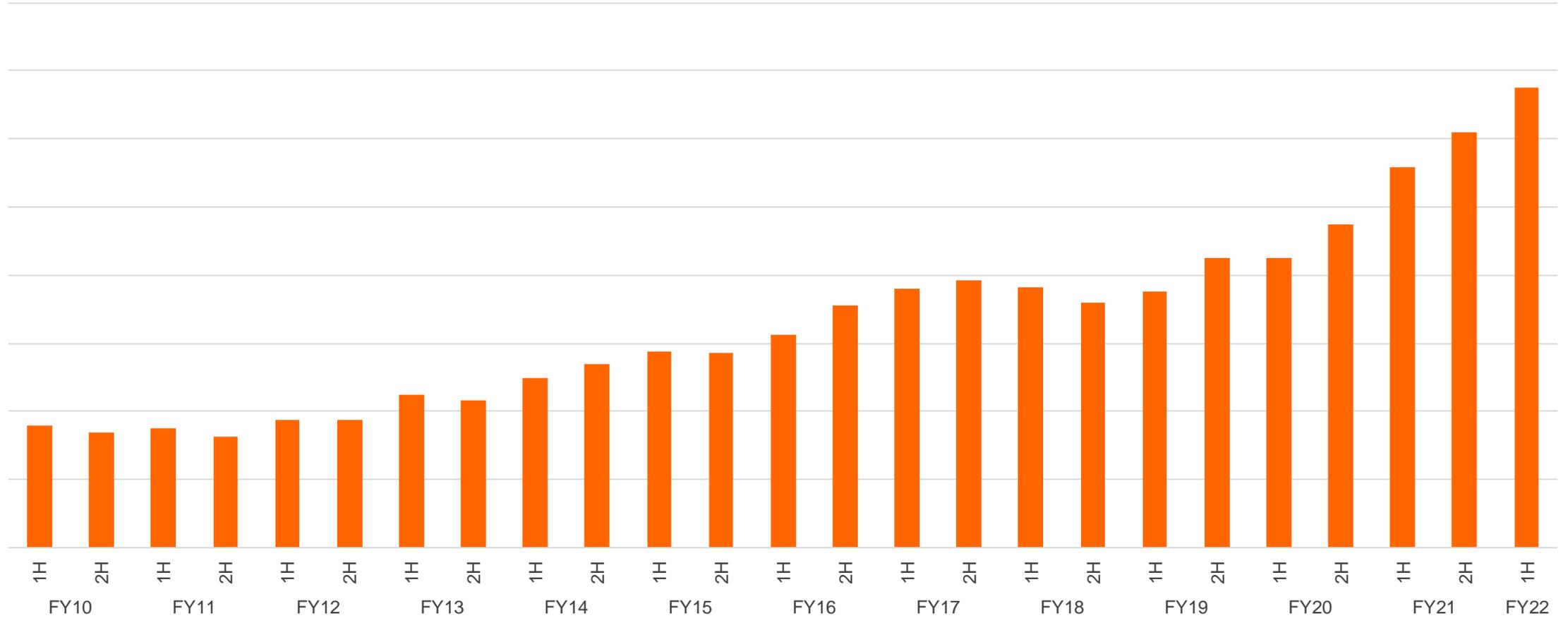
出荷額ベース

半期



出荷額ベース

半期



- 製品群別 用途別 データ集

## 出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	2Q	2Q	2Q
精密加工装置合計	62%	-2%	35%
内、ダイサ	37%	-3%	16%
ブレードダイサ	24%	2%	13%
レーザソー	13%	-12%	22%
内、グラインダ	22%	1%	56%
薄化DGP	12%	-10%	60%
薄化以外	10%	19%	52%
内、周辺装置	3%	2%	-
精密加工ツール	23%	1%	17%
その他	15%	13%	-15%
出荷額合計	100%	1%	20%

## 従来分類での構成比、増減率

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	2Q	2Q	2Q
精密加工装置合計	58%	-1%	28%
内、ダイサ	37%	-3%	16%
ブレードダイサ	24%	2%	13%
レーザソー	13%	-12%	22%
内、グラインダ	21%	1%	55%
薄化DGP	12%	-10%	60%
薄化以外	10%	19%	52%
内、周辺装置	-	-	-
精密加工ツール	22%	2%	10%
その他	20%	8%	11%
出荷額合計	100%	1%	20%

出荷額ベース

構成比		2021年度				2022年度	
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q
ダイサ	1_IC	54%	51%	52%	50%	53%	51%
	2_パッケージ・シグナレーション	15%	16%	16%	13%	14%	10%
	3_光半導体	9%	12%	10%	7%	6%	6%
	4_その他_半導体	10%	11%	18%	19%	22%	24%
	5_非半導体	12%	11%	4%	10%	5%	8%
<b>ダイサ</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
グライнда	1_IC	56%	51%	41%	49%	51%	47%
	2_光半導体	7%	14%	12%	4%	2%	3%
	3_その他_半導体	19%	12%	28%	25%	32%	35%
	4_素材ウエーハ	11%	16%	13%	14%	14%	13%
	5_非半導体	6%	7%	6%	8%	2%	2%
<b>グライнда</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

出荷額ベース

YoY		2021年度				2022年度	
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q
ダイサ	1_IC	63%	71%	80%	13%	16%	16%
	2_パッケージ・シングルレション	89%	84%	118%	37%	11%	-23%
	3_光半導体	-51%	1%	115%	12%	-25%	-38%
	4_その他_半導体	11%	42%	291%	215%	161%	152%
	5_非半導体	15%	32%	-50%	-7%	-50%	-9%
<b>ダイサ</b>		<b>26%</b>	<b>52%</b>	<b>86%</b>	<b>29%</b>	<b>18%</b>	<b>16%</b>
グライнда	1_IC	114%	39%	44%	15%	4%	44%
	2_光半導体	-29%	84%	62%	-6%	-71%	-63%
	3_その他_半導体	-25%	-15%	419%	97%	92%	360%
	4_素材ウエーハ	210%	265%	204%	179%	41%	24%
	5_非半導体	-20%	-13%	-47%	-22%	-62%	-59%
<b>グライнда</b>		<b>37%</b>	<b>42%</b>	<b>77%</b>	<b>34%</b>	<b>16%</b>	<b>56%</b>

出荷額ベース

QoQ		2021年度				2022年度	
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q
ダイサ	1_IC	-1%	-7%	21%	2%	1%	-7%
	2_パッケージ・シグナレーション	27%	1%	18%	-10%	3%	-31%
	3_光半導体	27%	26%	5%	-34%	-15%	4%
	4_その他_半導体	31%	12%	91%	13%	8%	8%
	5_非半導体	-8%	-15%	-52%	150%	-51%	55%
<b>ダイサ</b>		<b>6%</b>	<b>-2%</b>	<b>19%</b>	<b>5%</b>	<b>-4%</b>	<b>-3%</b>
グライнда	1_IC	36%	-32%	-2%	27%	23%	-6%
	2_光半導体	90%	41%	8%	-67%	-41%	78%
	3_その他_半導体	55%	-53%	195%	-8%	51%	12%
	4_素材ウエーハ	141%	6%	1%	8%	22%	-7%
	5_非半導体	-40%	-12%	8%	38%	-71%	-7%
<b>グライнда</b>		<b>39%</b>	<b>-25%</b>	<b>24%</b>	<b>4%</b>	<b>20%</b>	<b>1%</b>

# 【参考】地域別 構成比 アジアの内訳

検収ベース

■ 構成比	FY2021				FY2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	14%	12%	12%	11%	10%	10%		
アメリカ	7%	7%	5%	8%	9%	9%		
アジア	73%	76%	76%	76%	73%	73%		
シンガポール	8%	12%	10%	12%	11%	10%		
台湾	15%	19%	17%	18%	17%	18%		
韓国	12%	7%	7%	9%	14%	10%		
中国 ※	35%	37%	41%	35%	29%	34%		
その他	2%	1%	2%	1%	2%	1%		
ヨーロッパ	6%	4%	6%	6%	8%	7%		
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

※外資メーカー現地工場向け含む

検収ベース

従来分類	FY21_1Q	2Q	3Q	4Q	FY22_1Q	2Q
精密加工装置	50%	58%	56%	60%	53%	61%
精密加工ツール	28%	21%	24%	21%	26%	20%
部品	10%	7%	8%	7%	10%	8%
その他	10%	12%	10%	10%	9%	9%
産業用研削製品	2%	2%	2%	2%	2%	1%

新分類	FY21_1Q	2Q	3Q	4Q	FY22_1Q	2Q
精密加工装置	-	-	-	-	56%	65%
精密加工ツール	-	-	-	-	28%	21%
部品	-	-	-	-	10%	8%
その他	-	-	-	-	6%	5%
産業用研削製品	-	-	-	-	-	-